

2005.8 月版の
資料に間違い
有り。

→ 2005.8 月
東京エレテック株式会社

NSPACK, YSPACK, HSPACK, YSSOCKET の取り扱い上の注意

- 1) ご使用する IC は、NSPACK の適合可能な IC 寸法表上でご確認下さい。(同寸法表は、カタログを参照して下さい。)
- 2) NSPACK / YSPACK / HSPACK をケースから取り出す時、本体を押さえてからスポンジを先に取り出して下さい。
- 3) ケースを 50 以上の場所に長時間放置すると、希に変形する場合がありますので、保管については、40 以下の直射日光の当たらない場所に置いて下さい。
- 4) IC を NSPACK に搭載する場合、IC4 隅の樹脂部(封止剤部)のバリがないことを確認して下さい。バリがある場合、ナイフ等で除去して下さい。
- 5) IC のリードは強度が弱いため、NSPACK へ数回脱着することによりリードが曲がることが多いので、IC を NSPACK へ装着する時、リードの曲がりを点検・補正して下さい。
- 6) NSPACK に YSPACK / HSPACK をネジ止めする時、添付の専用ドライバー、またはトルクドライバーで 2 ケ所のネジを仮止め後、順次ネジを締めて下さい。(トルクは $0.55 \text{ cN} \cdot \text{m}$ を目安に固定して下さい。) 1 ケ所のみを強く締めると、接続不良の原因となることがあります。
- 7) YSPACK と YSSOCKET の挿抜において、こじったり、揺らしたりすると YSPACK のりが発生する恐れがありますので、(-)ドライバーで 4 方から少しずつ抜去して下さい。
- 8) YSPACK と接続する基板には、所定の位置に部品穴 (2 ケ所: 2.3mm) が必要です。ネジの頭の大きさ 3.8mm は配線禁止区域となります。
- 9) NSPACK をハンダ付けする際、フラックス飛散防止のため、HSPACK をカバーとして被せて下さい。
推奨ハンダ付け条件 ハンダリフロー: 260 × 10 秒以内、手ハンダ: 320 × 5 秒以内 (1 ピン)
熱風式ハンダ装置のご使用もお勧めします。
- 10) NSPACK、YSPACK、YSSOCKET は、構造上洗浄液がコネクタ内に残る恐れがあるため、洗浄は行わないで下さい。
- 11) NSPACK / IC / YSPACK の組合せでは、ご使用になれません。
- 12) NSPACK / IC / HSPACK の組合せは、評価用のコネクタとしてご使用下さい。
- 13) NSPACK / IC / HSPACK および NSPACK / YSPACK のシステムは、振動および衝撃環境にはご使用になれません。
- 14) NSPACK / IC / HSPACK の使用中に温度が上がり、IC の動作が不安定になる場合があります。その場合、扇風機等でコネクタ全体を冷却して下さい。
- 15) 本製品は、システムでの開発、評価での使用を想定したものです。また、国内の使用に際し、電気用品取締法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。

正しい値
 $0.054 \text{ N} \cdot \text{m}$
 $(0.55 \text{ kgf} \cdot \text{cm})$